



# 分享2007 ACE Awards 颁奖晚宴精彩时刻

作者：唐晓琪

在蓬勃发展的中国电子信息领域，作为产业最上游的芯片供应商，谁在过去一年获得了业界最大的品牌认可度？谁的产品服务最深入人心？谁是成长潜力最大的本土半导体公司？在与电子系统设计师息息相关的十大类半导体及相关产品中，谁最受工程师的青睐？在业界具有广泛影响力的《电子工程专辑》编辑的眼中，哪种电子产品将在未来发展中显示出强大优势？所有这些问题，都在首届《电子工程专辑》“年度电子成就奖(ACE Awards)”的颁奖晚宴中找到了答案。

2007年3月5日，伴随着第十二届国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China 2007)在深圳率先拉开序幕，首届《电子工程专辑》ACE Awards颁奖晚宴在深圳马哥孛罗好日子酒店如期举行。当晚，活跃在中国电子市场的半导体行业领先IC供应商、向工程师提供卓越解决



方案的技术供应商代表济济一堂，共同庆贺这一中国半导体行业盛事。

三年前，EETimes在美国首次推出了“ACE Awards”，旨在表彰那些帮助人类改变世界、具有领导和创新精神的技术公司。为了对美国“ACE Awards”进行延伸和补充，ACE Awards“来到”了中国。

“中国在世界舞台上的地位越来越重要，而今晚的获奖公司，都是在中国这个舞台上具有领导地位和创新精神的佼佼者。”EETimes总编辑Brain Fuller在晚宴上表示，“今晚，能与《电子工程专辑》的同事们一起揭晓首届电子成就奖，我感到非常荣幸。”

事实上，从去年9月开始，在短短六周时间内就有83家国际和本土公司参加了首届ACE Awards活动，为设立的24个奖项提交了224份提名。这24个奖项共分为三大类：《电子工程专辑》的编辑负责评选“编辑推荐奖”；中国工程师通过网上投票的形式评选“年度最佳产品奖”；专业评委团则评选出包括最佳品牌奖、杰出服务奖以及新兴公

司奖这三项“年度企业成就奖”。

为了得到公平公正的结果，《电子工程专辑》特地邀请了来自电子行业不同领域的六位专业人士组成评委团，他们分别是：中国计算机学会微计算机单片机学会理事长陈章龙、清华大学微电子学研究所教授魏少军、iSuppli首席代表及中国市场研究总监吴同伟、创维海外发展有限公司副总裁兼研发中心总经理吴伟、美国Gartner公司首席分析师徐永，以及《电子工程专辑》总编辑张毓波。

《电子工程专辑》的发行人Mark Saunderson在晚宴中用一句话贴切形容了当今电子行业的发展，那就是“逆水行舟，不进则退”。确实，今天的市场竞争日趋激烈，消费者希望产品具有更多功能，但是设计周期却在不断缩短。中国的系统设计工程师面临巨大压力，他们对创新技术和解决方案的需求空前高涨。

“今天晚上，我们向为工程师提供卓越解决方案的技术供应商，也就是在座的各位表示由衷的敬意，是你



们对卓越技术的不懈追求，使中国成为全球领先的创新产品的研发和制造中心。” Mark Saunderson先生在发言中表示。

### 年度企业成就奖

环球资源首席运营官Craig Pepples在晚宴中首先宣布了年度企业成就奖之“杰出服务奖”的候选名单：美国模拟器件公司、Microchip公司、NXP半导体、意法半导体以及德州仪器，并在大家的期待中将当晚第一个水晶杯授予了获得此项桂冠的NXP半导体公司。

NXP半导体在业界拥有53年的历史，是全球前十大的半导体公司，具有卓越的销售和服务体系、稳健的财务政策，以及长期牢固的客户关系。产品线更贴近中国市场，在中国投入最多。在中国多个重点城市建立了实验室、设计中心和专业团队，具有庞大的技术支持团队，对客户的反应速度快。目前在消费电子类领域中，与创维科技、TCL、长虹和康佳等国内知名生产商建立了良好的合作关系。

——评委组评语

随后，其余的23个奖项也在Craig Pepples、Mark Saunderson、《电子工程专辑》副发行人Bennie Hui以及总编辑张毓波手中一一揭晓。

“年度最佳品牌奖”的角逐十分激烈，五名候选者：美国模拟器件公司(ADI)、飞思卡尔半导体、安森美半导体、德州仪器、美国赛灵思公司均是国际领先的半导体公司，在中国市场拥有多年的经验，并取得了业界广泛的认可。评委组经过全面细致的讨论，最终将选票投给了德州仪器。

从品牌价值、认知度、文化和成长性等方面，TI均在中国有优秀的表现。它是集成电路的先驱，具有长期的积累，在业内被广泛认同；它是较早和国内高校建立技术合作及交流的国际知名半导体厂商，推进数字信号解决方案的学术计划，并设立培训中心；它积极利用媒体推广，在本地举办不同形式的展示会，创新能力强，鼓励文化本地化。目前，TI的DSP销量第一，在65nm新工艺及RFID新技术方面也不断出新。

——评委组评语

“年度新兴公司奖”在硅谷数模半导体、埃派克森微电子、澜起科技、上海杰得微电子以及天利半导体这五名候选公司中选出，最终埃派克森微电子以其在数/模混合电路设计中的出色表现，赢得了评委组的一致认可。

埃派克森微电子具有强劲的自主创新能力，其数/模混合设计很有特色，是模拟电路领域的后起之秀，产品与市场符合中国IC设计公司的发展趋势。目前多种产品已经获得了市场认同，并进入应用领域。该公司有较强的科研和管理团队，有广泛的国际合作伙伴，同时重视直销和分销模式，在设计公司的产品销售中独树一帜。

——评委组评语

### 编辑推荐奖

由于可同时实现宽带矢量信号分析和高性能频谱分析，泰克公司的RSA6100A系列实时频谱分析仪凭借在未来无线应用中的潜在优势赢得了“编辑推荐奖”奖杯。

RSA6100A能够显示时间轴上的频域图，使工程师看到信号频率内容如何随时间变化。这对于WLAN、RFID、HSDPA等新兴无线应用的信号观测和分析非常重要。

——编辑评语



Mark Saunderson、Craig Pepples、Bennie Hui和张毓波分别向获奖的公司代表颁发奖杯。



## 年度最佳产品奖

参加“年度最佳产品奖”角逐的，均是在一年内面市，并已经在中国得到推广的产品。该奖项共设十个单项奖，每个单项有5名入围产品。“年度最佳产品奖”入围名单一经在网站公布，就吸引了中国广大工程师的关注，工程师宝贵的投票为我们评选出了最终的20个获奖产品(每个单项奖2名)。

### AD/DA转换器IC类



ADI的AD7980是一款16位逐次逼近型模数转换器，工作于单电源VDD。它包含一个16位采样ADC和一个多功能串行接口，外部的参考电压REF最高可设置为5.5V。AD7980的功率与采样速率成线性关系，其兼容SPI的串行接口采用SDI输入。

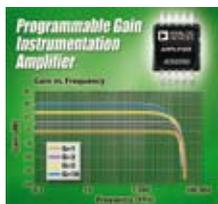


TI的 $\Delta$ - $\Sigma$ 型24位模数转换器ADS1232利用片上温度传感器监控环境温度。片上低噪声PGA提供1、2、64或128可选增益，能支持 $\pm 2.5V$ 、 $\pm 1.25V$ 、 $\pm 39mV$ 或 $\pm 19.5mV$ 的量程差动输入电压。它具备23.5位有效分辨率，可支持10SPS和80SPS两种数据速率。

### 放大器IC类



美国国家半导体的LM4562高保真度双组音频运算放大器只有0.0003%的总谐波失真及噪声，几乎没有失真。LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高速、广阔的操作电压范围以及高输出功率等优点，最适用于专业级及高端的音频系统。



ADI的AD8250通用仪表放大器实现高达12MHz的带宽。凭借BiCMOS制造工艺，AD8250数字可设置增益仪表放大器的拉电流只有3.5mA，比同类器件减小75%，并且采用10引脚超小外形塑料封装(MSOP)，比同类最接近的仪表放大器减小90%。

### MCU类



飞思卡尔MC9RS08KA的特性包括：2KB的第三代闪存、1.8伏至5.5伏的电源、集成时钟源(ICS)、8位模块定时器、模拟比较器、实时中断触发器、4条双向I/O线路、COP功能、3/5通道键盘中断(KBI)、低压检测(LVD)，且带有重置、停止或唤醒模式等。

### 接口芯片IC类

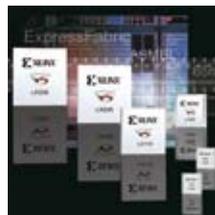


美国国家半导体的SCAN25100为全球首款CPRI串行/解串器，光纤延迟校准准确度可达800ps，可支持下一代基站结构。该芯片的延迟校准测量准确度达到 $\pm 800ps$ ，在信号电压及抖动方面的表现超过了CPRI接口标准的规定。



硅谷数模半导体(中国)有限公司的ANX90xx系列芯片完全兼容HDMI 1.1标准，能以最高每秒165兆像素的速率传输高达24位信息数据，使整个处理带宽接近4Gbps。支持RGB与多种模式YCbCr之间的转换，支持HDTV(最高支持1,080p)和PC(最高支持1,600x1,200@85Hz)。

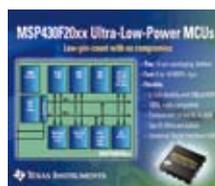
### 逻辑与可编程逻辑类



赛灵思公司的Virtex-5 LX是业界率先采用65nm技术的多平台FPGA系列。基于业界最先进的65nm三极栅氧化层技术、突破性的新型ExpressFabric技术和经过验证的ASMBL架构，主要针对高速逻辑应用市场而优化。



Altera的Stratix II GX FPGA系列是Altera第三代带嵌入式收发器的FPGA，能够为各种应用和需要高速串行I/O的协议提供功能强大的解决方案。工作频率为622~6,375Mbps，集成了20个基于串行/解串器的收发器，支持长度超过40"的标准FR-4电路板和背板。



TI的MSP430F20xx系列采用数字控制振荡器(DCO)，能够在无需外部组件的情况下提供高达16MIPS的工作速率。该DCO具备全面可编程性，运行频率高达16MHz。此外，该器件还可在不足1微秒的时间内从待机模式转换到全速工作状态。



## 年度最佳产品奖

### 存储器IC类



飞思卡尔的MRAM是一项创新的存储器技术，采用磁矩(而非电荷)来确定存储器位单元的开关状态。它可单独代替片内多种存储器，从而能够更快地实现针对新一代存储器密集型产品的更经济的解决方案。



Cypress半导体公司的nvSRAMs在断电情况下，无需电池就能实现内部数据的存储。在RAID应用中，nvSRAM在提供高速数据传输的同时还能确保断电情况下的数据完整性；对复印机而言，nvSRAM提供了较快的数据存取速度，不再需要电池。

### 电源IC类



凌力尔特公司的LTM4600是具有内置电感器的同步开关模式DC/DC降压型稳压器，适用于4.5V至28V的宽输入电压范围。该器件可在92%效率时提供10A的连续电流(峰值为14A)。LTM4600 DC/DC uModule是一个完全独立的表面贴装电源器件。



安森美半导体的NCP1337是一款增强型PWM电流模式控制器。该器件提供了内部变压器磁芯去磁检测后，不需要任何外部信号。NCP1337频率内部限制为130kHz，符合EMI导电辐射标准；具有无线圈谷底开关及待机较纹波模式，并具有输入欠压保护。

### 处理器与DSP类

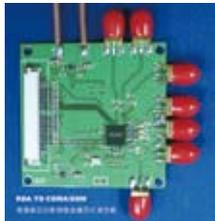


TI的TMS320DM644x是一款基于达芬奇技术的高集成SoC，建立在TI的TMS320C64x+DSP内核基础之上，其集成的ARM926处理器、视频加速器、网络外设及外部存储器/存储设备接口等都专门为视频功能进行了调节。TMS320DM6443针对视频编码及解码应用进行了优化，TMS320DM6446则特别适合视频编码。

### 射频与微波IC类



飞思卡尔的RFX300-20/30是多模/多频段WCDMA/EDGE RF子系统，前者集成GSM收发器、GSM/EDGE PA模块及三频段WCDMA收发器和PA模块；后者集成APC PA模块、收发器模块及电源管理。主要特点是高集成度。



锐迪科微电子的TD-SCDMA终端射频芯片是全球首款CMOS工艺的高性能、双模单芯片TD-SCDMA终端射频芯片。双频射频收发器方案支持2,010~2,025MHz和1,880~1,920MHz频段以及GSM标准的四个频段，可在六个频段上自由切换。通用性好，支持现有所有的TD-SCDMA基带芯片。

### 测试与测量产品类



安捷伦的16800系列逻辑分析仪包含八款固定配置的新機種，具有高性能的测量能力，体积更小，采用固定的配置，功能先进但价位却相当经济，符合当下计算机、通信、半导体、无线通信等产业的数字设计人员解决量测问题的需要。此系列是业界唯一可以单独将抽取内存容量和状态速度升级的機種。



National Instruments的LabVIEW 8.2具有图形化、面向对象的编程方式以及友好的操作界面、良好的代码复用性、出色的控制特性，在简单易用的图形化编程环境基础上添加了更多用于开发测量应用程序的功能强大的诸多特性，同时也提供更多的开放式连接工具。



ADI的SoftFone-LCR芯片组采用流行的基于RAM的SoftFone体系结构为基础。该芯片组包括一个数字基带处理器，它基于ADI的Blackfin处理器，因而达到优于250MHz的性能。SoftFone-LCR芯片组的基带信号处理功能，包括联合检测(JD)和译码，完全是用嵌入式Blackfin处理器内核中运行的软件实现的，而不是用硬件实现的。